(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/205932 A1

(51) 国際特許分類:
*C09J 201/00* (2006.01) *C09J 183/07* (2006.01)
*C09J 11/02* (2006.01) *H01L 21/02* (2006.01)
*C09J 11/08* (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
*C09J 183/05* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/012013

(22) 国際出願日： 2025年3月26日(26.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-051051 2024年3月27日(27.03.2024) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(**NISSAN CHEMICAL CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 (JP).

(72) 発明者: 臼井 友輝(**USUI Yuki**); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 奥野 貴久(**OKUNO Takahisa**); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 岸岡 高広(**KISHIOKA Takahiro**); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP).

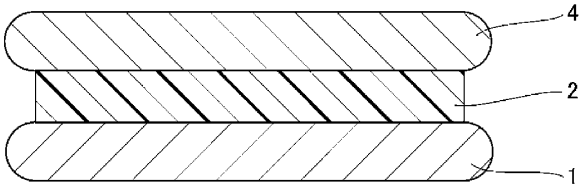
(74) 代理人: 高岡 亮一, 外(**TAKAOKA Ryoichi** et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋５－４－７ 池袋トーセイビル５階 高岡ＩＰ特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,

(54) **Title:** ADHESIVE COMPOSITION, LAMINATE, AND METHOD FOR PRODUCING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称： 接着剤組成物、積層体、及び加工された半導体基板の製造方法




(57) **Abstract:** With respect to a laminate having a first substrate that is a semiconductor substrate or an electronic device layer, a second substrate that is an infrared laser-transmissive support substrate, and an adhesive layer provided between the first substrate and the second substrate, this adhesive composition serves to form the adhesive layer used to separate the first substrate and the second substrate after processing of the first substrate and then irradiation of the adhesive layer with the infrared laser from the second substrate side. The adhesive composition contains a siloxane bond-bearing adhesive component, a release agent component, and an infrared absorber.

(57) 要約：半導体基板又は電子デバイス層である第１基体と、赤外線レーザーを透過する支持基板である第２基体と、前記第１基体と前記第２基体との間に設けられた接着剤層とを有する積層体における前記第１基体を加工後に、前記第２基体側から前記赤外線レーザーを前記接着剤層に照射し、その後、前記第１基体と前記第２基体とを分離することに用いられる前記接着剤層を形成するための接着剤組成物であって、シロキサン結合を有する接着剤成分と、剥離剤成分と、赤外線吸収剤とを含有する、接着剤組成物。

WO 2025/205932 A1

［続葉有］

ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）